

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2006年1月5日 (05.01.2006)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2006/001136 A1

- (51) 国際特許分類: C08L 51/00, 23/00, 23/26, 53/00
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2005/008954
- (22) 国際出願日: 2005年5月17日 (17.05.2005)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
- | | | |
|---------------|-------------------------|----|
| 特願2004-187255 | 2004年6月25日 (25.06.2004) | JP |
| 特願2004-187256 | 2004年6月25日 (25.06.2004) | JP |
| 特願2004-217344 | 2004年7月26日 (26.07.2004) | JP |
| 特願2005-013263 | 2005年1月20日 (20.01.2005) | JP |
| 特願2005-020384 | 2005年1月27日 (27.01.2005) | JP |
| 特願2005-072086 | 2005年3月14日 (14.03.2005) | JP |
| 特願2005-128377 | 2005年4月26日 (26.04.2005) | JP |

(74) 代理人: 井出正威, 外 (IDE, Masatake et al.); 〒1020076 東京都千代田区五番町3-1 五番町グラ
ンドビル9階井出国際特許事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): テクノポリマー株式会社 (TECHNO POLYMER CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1040041 東京都中央区新富二丁目15番5号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 馬渡 政明 (MAWATARI, Masaaki) [JP/JP]; 〒1040041 東京都中央区新富二丁目15番5号 テクノポリマー株式会社内 Tokyo (JP). 岩崎 由浩 (IWASAKI, Yoshihiro) [JP/JP]; 〒1040041 東京都中央区新富二丁目15番5号 テクノポリマー株式会社内 Tokyo (JP).

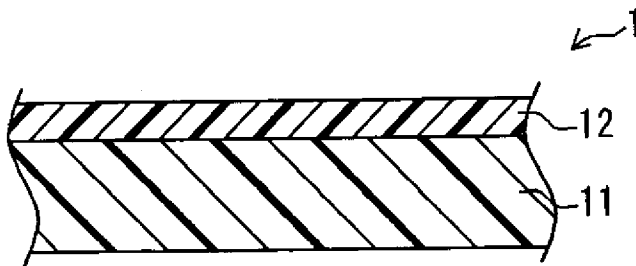
添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: THERMOPLASTIC RESIN COMPOSITION AND MOLDED ARTICLE

(54) 発明の名称: 熱可塑性樹脂組成物および成形品



(57) Abstract: Disclosed is a thermoplastic resin composition which is characterized by containing 5-100 mass% of the below-described component (A) and 95-0 mass% of the below-described component (B) (with the total of the component (A) and the component (B) being 100 mass%) and further containing 0.5-100 parts by mass of the below-described component (C1) per 100 parts by mass of the total of the component (A) and the component (B). Component (A): a styrene resin obtained by (co)polymerizing an aromatic

vinyl compound, or an aromatic vinyl compound and another vinyl monomer copolymerizable with the aromatic compound in or without the presence of a rubber-like polymer. Component (B): an olefin resin. Component (C1): a block copolymer containing an olefin polymer block and a hydrophilic polymer block. Such a composition enables to obtain a molded article which is excellent in impact resistance, chemical resistance, surface appearance, and antistatic properties or charge controlling properties.

(57) 要約: 下記 (A) 成分 5~100質量%及び (B) 成分 95~0質量%を含有してなり (但し、該 (A) 成分及び (B) 成分の合計は100質量%)、さらに、下記 (C1) 成分を該 (A) 成分及び (B) 成分の合計100質量部に対して0.5~100質量部含有してなることを特徴とする熱可塑性樹脂組成物。(A) 成分: ゴム質重合体の存在下又は非存在下に、芳香族ビニル化合物、又は芳香族ビニル化合物及び芳香族ビニル化合物と共重合可能な他のビニル単量体を (共) 重合してなるスチレン系樹脂、(B) 成分: オレフィン系樹脂、(C1) 成分: オレフィン重合体ブロックと親水性ポリマーブロックとを含有するブロック共重合体。該組成物は、耐衝撃性、耐薬品性、成形品の表面外観、及び帯電防止性ないしは制電性に優れた成形品を与える。

WO 2006/001136 A1